

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成17年8月4日(2005.8.4)

【公開番号】特開2003-209058(P2003-209058A)

【公開日】平成15年7月25日(2003.7.25)

【出願番号】特願2002-6297(P2002-6297)

【国際特許分類第7版】

H 01 L 21/205

C 23 C 16/44

【F I】

H 01 L 21/205

C 23 C 16/44 J

【手続補正書】

【提出日】平成17年1月12日(2005.1.12)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

複数の成膜室を有する半導体製造装置において、

各成膜室の排気ラインは共通ラインに至り、この共通ラインに除害装置が接続され、

いずれかの成膜室でクリーニング時期に達すると、クリーニング時期に達した成膜室と他の成膜室を併せてクリーニング処理することを特徴とする半導体製造装置。